



Systemdatenblatt

SL Floor WHG AS 01

Positionen

- **Stahlkugelstrahlen von mineralischen Flächen**
- **Grundierung mit einem WHG- und DIBt-geprüftem 2-K EP-Bindemittel**
mind. 0,30 kg/m² Epoxy GL 100 <1427> (je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes)
- *** Grundposition
- **Egalisierung von Rauigkeiten mit einem WHG- und DIBt-geprüftem 2-K EP-Bindemittel (<1 mm)**
ca. 0,5 kg/m² Remmers Epoxy GL 100 <1427>
ca. 0,50 kg/m² Remmers Selectmix 01/03 <4405>
ca. 0,5 kg/m² Remmers Epoxy GL 100 <1427>
- **Leitfähige Querleitschicht aus einem wässrigen 2-K EP- Bindemittel inkl. Erdungselementen**
mind. 0,15 kg/m² Remmers Epoxy Conductive LE <6701> ca. 0,1 - 0,5 m/m² Remmers Kupferlitze <4551>
Remmers Remmers Leitset <4933>: Die Gesamtanzahl der Anschlusspunkte ist abhängig: - von der Größe und Geometrie der Fläche - max. Abstand der Kupferlitzten Erfahrungswert: 2 Erdungspunkte pro 100 m²
- **Beschichten mit einem rissüberbrückenden, pigmentierten, ableitfähigen WHG- und DIBt-geprüften 2-K EP-Bindemittel**
1,5 kg/m² Remmers Epoxy WHG Color AS (bei senkrechten Flächen ist anteilig Remmers WHG TX zuzugeben): ca. 1,5-2,5 % bez. Auf die Bindemittelmenge
- **Einblasen von Struktur-/Mattierungsmittel**
ca. bzw. bis zu 0,05 kg/m² Remmers Glimmer GHL 3/0 <6742>